



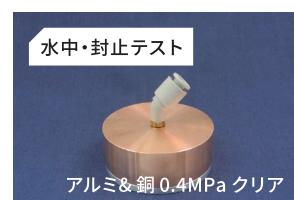
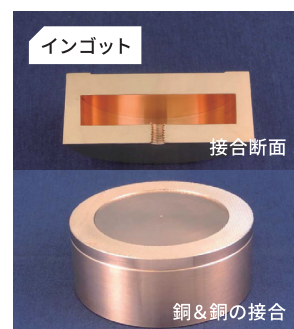
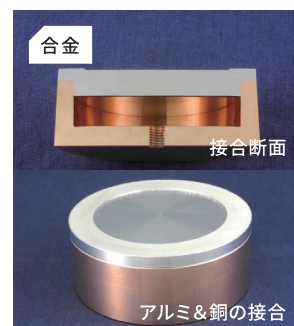
Patented

Application

Bonding ボンディング

各種金属のインゴット合金三次元接合

ハーメチック封止接合



Product used 使用する装置

15MZs [VVBホーン]



AP-J-0046A4-2021093001